

半導体製造装置開発の最前線

～業界トップクラスの技術者が登壇
技術をわかりやすく解説します～

講演内容

■ 研磨技術概論

CMP装置の基礎

株式会社荏原製作所 岩佐 毅彦

現在、半導体製造において必須工程の一つとなっているCMP装置(化学的機械的研磨装置)の基本構成、重要要素技術、近年の課題について解説します。

■ 研削技術概論

アドバンスドパッケージに呼応するバックグランド技術の最新動向

株式会社東京精密 佃 昌治

近年、パッケージ技術の発展に伴いバックグランド技術は従来の基板薄化目的からデバイス、もしくはパッケージ自体の機能向上を目指す手段として適用範囲を拡大しています。本講演ではバックグランド工程に求められる最新技術を紹介致します。

■ 樹脂封止技術概論

半導体の保護だけでなく高機能化を支えるモールドイング技術

TOWA株式会社 白澤 賢典

半導体はさらなる高機能化、限られた設置空間への搭載が求められています。これらを実現するにはパッケージングの小型・軽量化・信頼性を高める必要があります。こうした要求に応えるためのモールドイング技術について紹介致します。

■ 試験技術概論

半導体デバイスの機能・性能・品質・信頼性を保証し、「良品」という付加価値を与える

株式会社アドバンテスト 石田 雅裕

半導体デバイスの微細化・高集積化に伴い、搭載機能の増加、回路性能の向上が進むに連れて、品質と信頼性に対する要求はより厳しくなっています。デバイスの機能・性能・品質・信頼性を保証するために、デバイス試験が重要な役割を果たします。本講演では、半導体デバイスの試験技術について概略を紹介致します。

お申し込みはこちら



2025年

3月17日 月

13:15～15:50 千葉工業大学 津田沼キャンパス 435室

主催

公益社団法人 精密工学会 (JSPE)

協賛・後援

一般社団法人 日本半導体製造装置協会 (SEAJ)

参加費
無料